

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-075

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日接待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2022 年 9 月 22 日

调研地点：同享科技会议室

调研形式：现场调研

调研机构：中金公司、森锦、健顺投资、招行总行、泰旻资产、玺悦资产、淡泰资本、国君自营、博鸿资产、旌安投资、广发自营、晖锐资本、瀑布资管。

上市公司接待人员：董事长陆利斌先生、董事会秘书蒋茜女生。

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：关于公司新项目 15000 吨产能目前的进展情况如何？

回答 1：该项目自今年年初已开始逐步建设并投产，目前大约已经达到 3000 吨的产能。

问题 2：公司在晶科的供货占比大约是多少？

回答 2：目前大约占晶科焊带总体需求量的 40%左右。

问题 3：SMBB 焊带相较于 MBB 焊带在用量方面有什么变化？

回答 3：目前 topcon 电池片上最大是 18BB，1GW 的焊带用量在 450 吨左右，随着 SMBB 焊带的推广，焊带用量会进一步提升。异质结无主栅技术推广后，栅数大约会提升至 24BB，虽然焊带线径有所下降，但根数的增加导致总体用量呈上升趋势。

问题 4：对于异质结无主栅技术，公司是否也有技术储备？

回答 4：该技术领域使用的焊带公司在去年已规划储备，异质结技术主要使用低温银浆，焊带会往低温焊接方向发展，无主栅的技术实际是焊带线径的进一步变细，目前市面上的焊带普遍线径在 0.26-0.32mm 之间，未来发展到无主栅技术时焊带线径会低于 0.2mm，生产难度进一步提升。对于这些技术，公司除向客户送样实验外，还通过与先进光伏设备制造商迈为合作的方式进行异质结技术的共同研发，致力于推动行业技术发展，并使公司生产技术保持业内领先水平。

问题 5：随着 MBB 焊带向 SMBB 焊带技术的演变及推广，公司的市场份额是否有进一步提升的可能？

回答 5：焊带线径的降低在焊接应用中可以充分区分出不同焊带厂商的技术能力，焊带厂商间技术的差异化会越来越大。从技术角度来看，SMBB 焊带的普遍应用有望提升公司的市场份额。

问题 6：一般需要多久的生产经验才能掌握目前比较领先的焊带生产技术？

回答 6：生产技术的掌握并不能仅仅用从业时间来衡量，生产的焊带保持长期稳定的工艺涉及多方面因素，并非仅通过不断的生产就能获得技术上的突破与进步。

问题 7：简述公司对未来行业发展路线的预测。

回答 7：主要有两种发展方向，一种是异质结无主栅路线，另一种是 HPBC 路线，是异质结和 IBC 结合的模式，IBC 当前的主要优势是组件正面通过无焊带的方式减少光的遮挡率，依靠组件背面的焊带传输电流，这种技术目前使用的主要是超细扁线。IBC 的技术仍处于实验阶段，是未来的发展趋势之一。

问题 8：简述公司铜材的采购方式以及定价方式，公司是否有通过期货市场对材料成本进行锁定？公司如何对铜价走势进行判断？

回答 8：公司在取得客户订单后，根据库存及生产规划等向铜冶炼企业采购铜材，按照现货价格定价。由于客户的定价方式是按照现货材料价格加上加工费的方式，公司利润相对稳定，无需通过期货控制材料成本。

铜材价格的行情走势主要受到国际形势影响，期货市场风险相对较大，为确保公司经营业绩的稳定，因此，暂未通过期货市场锁定原材料采购成本。

问题 9：公司通过与迈为合作研发的方式对低温焊带进行提前规划，如果异

质结技术得到推广，公司是否能相比其他企业更具发展优势？

答案 9：新产品在应用过程中会出现各种问题，公司对该技术的提前布局相当于提前解决了这些问题，若该项技术未来得到推广，公司可以更好的抓住机会，提高市场份额。

问题 10：除目前的业务外公司是否有其他领域扩展的规划？

答案 10：未来新能源行业的发展可能会在不同领域出现相互结合的现象，比如光伏和储能就是发展的大趋势，另外光伏行业与新能源汽车可能也会有一些技术衔接，这些都是公司未来规划的方向，具体的发展方向还需要结合多方面的因素谨慎确定。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日